

6インチ 円形 Ptfе製 ウェーハキャリア 耐酸・耐アルカリ性 半導体洗浄用フラワーバスケット カスタマイズ対応

商品番号: PL-CP55



前書き

重要な半導体ウェット処理向けに設計された高純度6インチPTFE製ウェーハキャリアです。極めて高い耐薬品性と熱安定性を備えたこのカスタマイズ可能なフラワーバスケットは、生産プロセス全体にわたる過酷な酸性・アルカリ性浸漬環境下で、均一な洗浄と基板の保護を実現します。

詳細を学ぶ

用途	説明	主なメリット
半導体RCA洗浄	有機汚染やイオン性汚染を除去するため、SC-1溶液およびSC-2溶液にウェーハを浸漬	酸化剤および高温塩基に対して完全な耐性を発揮
ウェットエッチングプロセス	フッ化水素酸（HF）またはリン酸を用いた材料層の選択的除去	基板を正確に位置決めすることで、ウェーハ全体で均一なエッチング深さを実現
フォトリソグラフィレジスト剥離	強力な有機溶剤またはピラニア溶液を用いたフォトレジスト層の除去	強溶剤に暴露されても素材が膨潤または劣化しない
太陽電池のテクスチャリング	効率向上のためのシリコンウェーハの大量洗浄・表面テクスチャリング	耐久性のある設計が、産業規模の薬液処理の過酷な条件に耐える
CMP後のリンス	化学機械研磨後のスラリー粒子および薬品の除去	超平滑な表面が粒子の再付着を防ぎ、容易なリンスを可能にする
微量分析前処理	濃硝酸または濃塩酸による高純度実験室部品の洗浄	超微量元素分析における交差汚染リスクを排除
MEMS製造	微小電気機械システム生産のための特殊基板ハンドリング	カスタマイズ可能なスロット寸法により、非標準の基板厚に対応

パラメータ	PL-CP55の仕様
製品識別	PL-CP55 円形ウェーハキャリア（フラワーバスケット）
素材構成	高純度バージンポリテトラフルオロエチレン（PTFE）
ウェーハサイズ適合性	6インチ（150mm）標準（カスタムサイズ対応可能）
構成	円形スロット式バスケット / 孔あきフラワーデザイン
スロット数 / 容量	カスタマイズ可能（標準：10、25、または50スロット）
使用温度	-200°C～+260°C（-328°F～+500°F）
耐薬品性	pH 0-14（全ての酸・アルカリ・溶剤に耐性）
スロット幅 / ピッチ	ユーザー仕様に応じてフルカスタマイズ可能
ハンドルタイプ	一体型固定ハンドル または 脱着式PTFEスイングハンドル（カスタマイズ可能）

パラメータ	PL-CP55の仕様
表面仕上げ	CNC加工平滑仕上げ（標準 Ra ≤ 0.8μm）
製造方法	100%精密CNC加工（特注製品）
寸法	特定のウェットベンチまたはタンク寸法に合わせて特注設計